**技术领域及背景**

技术领域

 本发明涉及一种不烧镁铬砖。

技术背景

 镁铬砖在烧制过程中，生成尖晶石时的膨胀会引起松散效应，不烧镁铬砖采用镁砂和铬矿为原料，添加结合剂，经高压成型、低温热处理制成。不烧镁铬砖与烧成制品相比，制作工序简单、成本低，而且常温耐压强度高、气孔率低、热震稳定性好。

 但是，不烧镁铬砖通常采用聚磷酸盐作为结合剂，聚磷酸盐在高温下将会分解而使不烧镁铬砖强度变低。